

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司

关于向银行申请及预计 2025 年综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司申请新增授信额度的基本情况

根据西安紫光国芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司西安长安路支行申请授信人民币 1.75 亿元，资金使用期限为 1 年；拟向北京银行股份有限公司西安分行申请授信人民币 1 亿元，资金使用期限为 3 年。具体情况如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司西安长安路支行申请综合授信人民币 1.75 亿元

- 授信申请主体：西安紫光国芯半导体股份有限公司
- 授信银行：中国建设银行股份有限公司西安长安路支行
- 授信金额：人民币 1.75 亿元整
- 利率：以贷款产品实际审批为准（预计为贷款基准利率）
- 授信期限：1 年
- 资金使用期限：1 年期
- 担保方式：无担保

2、拟向北京银行股份有限公司西安分行申请综合授信人民币 1 亿元

- 授信申请主体：西安紫光国芯半导体股份有限公司

- (2) 授信银行：北京银行股份有限公司西安分行
- (3) 授信金额：人民币 1 亿元整
- (4) 利率：以贷款产品实际审批为准（预计为贷款基准利率）
- (5) 授信期限：1 年
- (6) 资金使用期限：3 年期
- (7) 担保方式：无担保

二、公司预计 2025 年申请综合授信额度的基本情况

公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 9.45 亿元人民币的综合授信额度，各家银行综合授信额度计划如下（最终以各银行实际审批的额度为准）：

币种：人民币 单位：万元

银行名称	已有授信额度	是否需要 2025 年续授信	2025 年拟调减综合授信额度	2025 年拟新增综合授信额度	综合授信总额	是否需要担保
中信银行	12,000	是	-	-	12,000	否
中国工商银行	5,000	是	-	-	5,000	否
招商银行	20,000	是	-	-	20,000	否
上海浦东发展银行	30,000	是	-	-	30,000	否
中国建设银行	-	-	-	17,500	17,500	否
北京银行	-	-	-	10,000	10,000	否
合计	67,000	-	-	27,500	94,500	-

上述综合授信的有效期为一年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，授信额度在授信期限内可循环使用。

上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会审议。

以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权

经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

三、表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于公司向建设银行、北京银行申请人民币授信的议案》。

公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

四、申请授信的必要性及对公司的影响

公司向银行申请授信是公司日常业务发展及经营的正常所需，为公司的业务增长提供所需流动资金保障，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，不会对公司及股东利益造成损害。

五、备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《西安紫光国芯半导体股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

特此公告。

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日